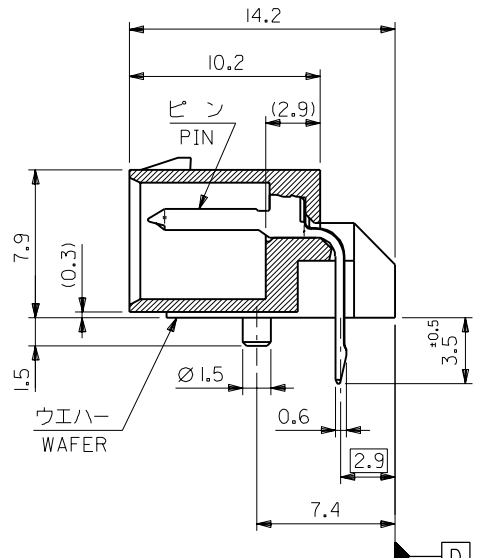
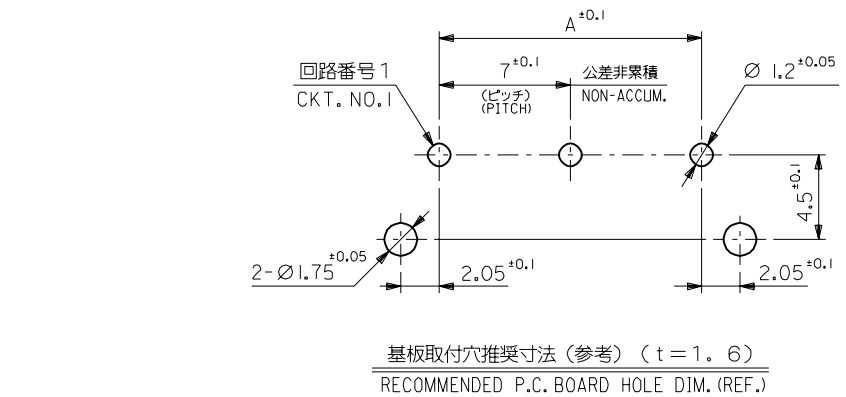
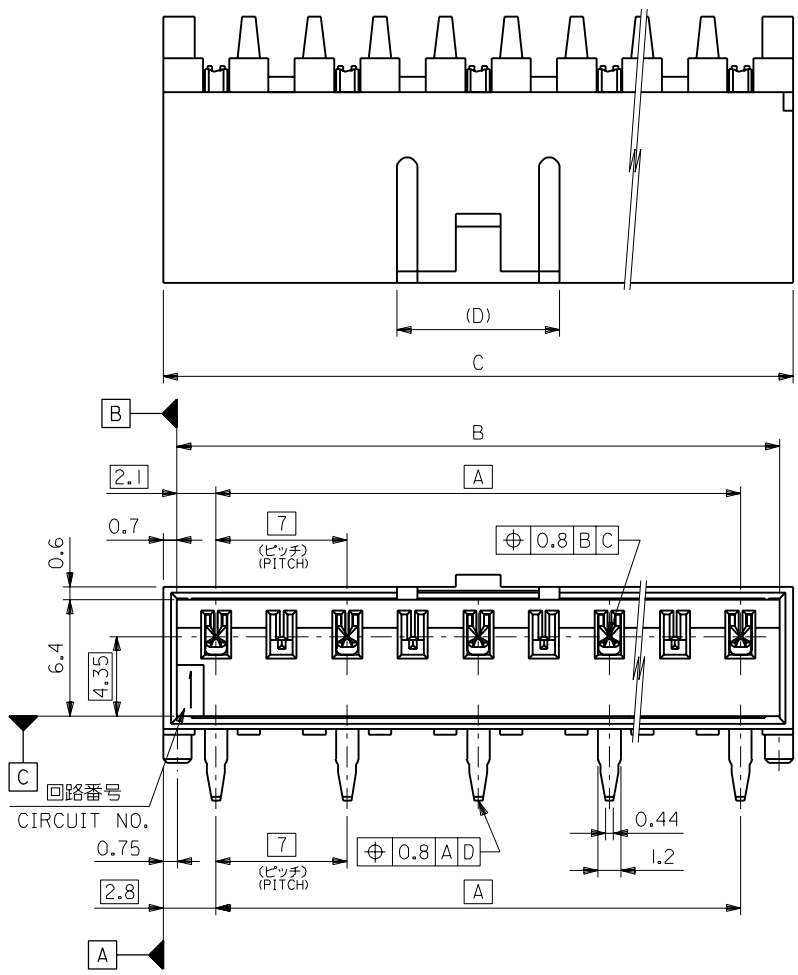


EDP NO. SD-53266-***0
 ENG. NO. SD-53266-***0
 DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



8.7	54.6	53.2	49.0	53266-0820	8
				-0810	
	47.6	46.2	42.0	-0720	7
				-0710	
	40.6	39.2	35.0	-0620	6
				-0610	
	33.6	32.2	28.0	-0520	5
				-0510	
	26.6	25.2	21.0	-0420	4
				-0410	
8.7	19.6	18.2	14.0	-0320	3
				-0310	
6.1	12.6	11.2	7.0	-0220	2
				53266-0210	
(D)	C	B	A	ENG. NO.	CKT. 極致

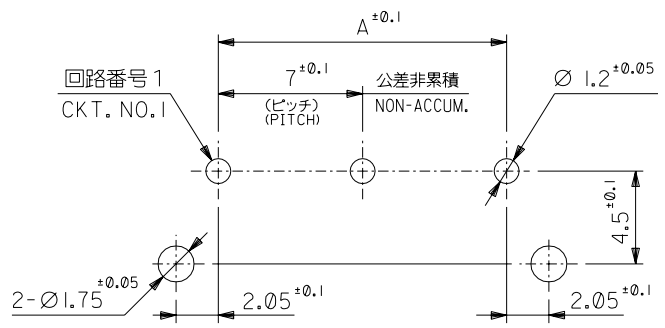
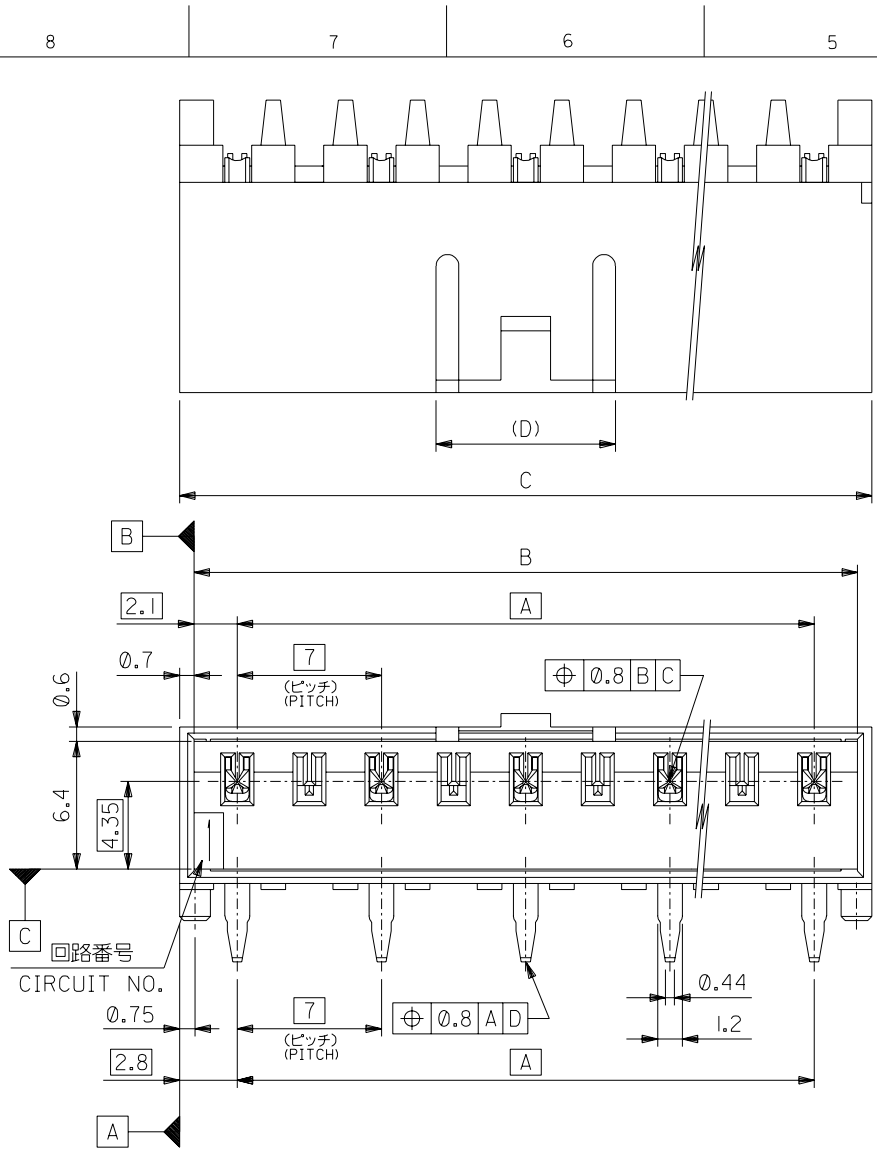
注記 NOTES
 1. 嵌合相手 : 51067 シリーズ
 MATE WITH : 51067 SERIES
 2. 材質
 MATERIAL
 ウエハー : PBTP (ガラス15%入り)、UL 94V-0
 WAFER : PBTP (G.F 15%), UL94V-0
 ピン : 53266-***10 [リン青銅、錫メッキ (t=0.254)]
 PIN : [PHOS. BRO., PRE-TINNED (t=0.254)]
 53266-***20 [黄銅、錫メッキ (t=0.254)]
 [BRASS, PRE-TINNED (t=0.254)]

角度 ANGLE	±3°	B	変更 REVISD (J30648)	M.F.	'93/6/29
30以上 OVER	+0.3	A	変更 REVISD (J10934)	K.A.H.A.	'91-10-31
10以上 30未滿 UNDER	+0.25	O	新規作成 PROPOSED (J00265)	M.F.	'90-3-12
10未滿 UNDER	+0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
一般公差 GENERAL TOLERANCES			REVIS ONLY ON CAD SYSTEM		

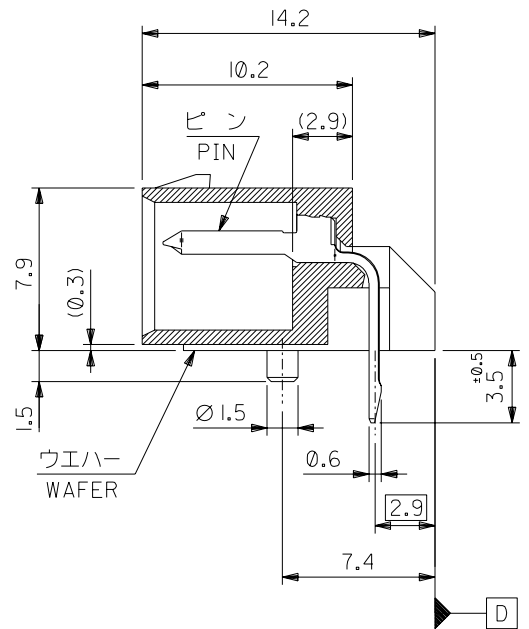
材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	—	
適用電線範囲 WIRE RANGE	—	EDP. NO. —
被覆外径 INS. RANGE	—	ENG. NO. SD-53266-***0
DRAWN BY '90-3-12 K.ASAKAWA	CHK'D BY '93/6/29 H.HIRAMOTO	TITLE 名称 7.0 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y (R/A)
APP'D BY '93/6/29 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE —	REV B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス (株) の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EDP. NO. # / ENG. NO. SD-53266-002 / DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



基板取付穴推奨寸法 (参考) (t=1.6)
RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE DIM. (REF.)



8.7	54.6	53.2	49.0	53266-0829	8
	47.6	46.2	42.0	-0729	7
	40.6	39.2	35.0	-0629	6
	33.6	32.2	28.0	-0529	5
	26.6	25.2	21.0	-0429	4
8.7	19.6	18.2	14.0	-0329	3
6.1	12.6	11.2	7.0	53266-0229	2
(D)	C	B	A	MATERIAL NO.	CKT. 極数

- 注記 NOTES**
1. 嵌合相手 : 51067 シリーズ
MATE WITH : 51067 SERIES t
 2. 材質
MATERIAL
ウエハー : PBTP (ガラス15%入り)、UL94V-0
WAFER : PBTP (G.F 15%), UL94V-0
ピン : 53266-***29 [黄銅、ニッケル下地、錫メッキ (t=0.254)]
[BRASS, OVER NICKEL PLATED, TIN (t=0.254)]
 3. 本製品は53266-***20の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53266-***20.

53266-***29	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
MODEL NO.	仕上げ FINISH	—	EDP. NO. —	
角度 ANGLE ±3°	適用電線範囲 WIRE RANGE	—	ENG. NO. SD-53266-002	
30以上 OVER ±0.3	被覆外径 INS. RANGE	—	REV 0	
10以上 OVER 30 UNDER ±0.25	記号 新規作成 (2004-4323) M.M. K. 04/05/19	DR. DATE	TITLE 名称	
10 UNDER ±0.2	記号 変更内容 REVISION RECORD DR. CHK. DATE	APP'D BY M.SASAO	7.0 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y (R/A) -LEAD FREE-	
一般公差 GENERAL TOLERANCES	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		DRAWN BY '04/05/19 M.NAGATA CHK'D BY '04/05/19 K.TOJO SCALE —	